(n)公開特許公報 (A)

(11)特許出願公開番号

特開平10-78568

(43)公開日 平成10年(1998) 3月24日

(51) Int. Cl. 6

識別記号

庁内整理番号

FΙ

技術表示箇所

G02F 1/035

G02F 1/035

審査請求 未請求 請求項の数18 OL (全10頁)

(21)出願番号

特願平8-235451

(22)出願日

平成8年(1996)9月5日

(71)出願人 000005223

富士通株式会社

神奈川県川崎市中原区上小田中4丁目1番

1 景

(72) 発明者 伊藤 知幸

北海道札幌市中央区北一条西2丁目1番地

富士通北海道ディジタル・テクノロジ株

式会社内

(72)発明者 髙松 久志

北海道札幌市中央区北一条西2丁目1番地

富士通北海道ディジタル・テクノロジ株

式会社内

(74)代理人 弁理士 松本 昂

最終頁に続く

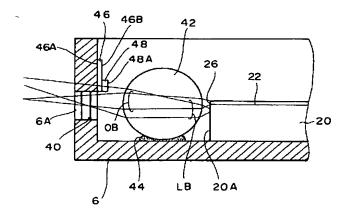
(54) 【発明の名称】光変調器モジュール

(57)【要約】

【課題】 本発明は光源からの光を変調するための光変 調器モジュールに関し、漏洩ビームによる光パワーのモ ニタリングを可能にする製造性に優れた上記モジュール の提供を課題とする。

【解決手段】 マッハツェンダ型の光導波構造22と、 光導波構造22から出力ビームOBが得られる結合モー ドと漏洩ビームLBが光導波構造22からそれる漏洩モ ードとを切り換えるための手段と、漏洩ビームLBを受 ける受光面48Aを有するフォトディテクタ48と、受 光面48Aが光導波構造22に密着しないように漏洩ビ ームLBのビームパラメータを変換する手段(42)と から構成する。

第1実施形態を示す部分断面図



【特許請求の範囲】

【請求項1】 入力ポートが受けた光を変調して変調さ れた光を出力ポートから出力する光変調器モジュールで あって、

1

上記入力ポート及び出力ポートにそれぞれ動作的に接続 される第1端及び第2端と該第1端及び第2端にそれぞ れ接続される第1Y部及び第2Y部と該第1Y部及び第 2 Y部の間に接続される第1パス及び第2パスとを有す る光導波構造と、

上記第2Y部を通過する光が上記第2端に供給される結 10 イレンズを含み、 合モードと上記通過する光が上記光導波構造からそれて 漏洩ビームを生じさせる漏洩モードとを切り換えてそれ により上記変調された光が上記第2端から出力されるよ うに上記第1パス及び第2パスの少なくともいずれか一 方に電界を印加するための駆動手段と、

上記漏洩ビームを受ける受光面を有するフォトディテク タと、

上記受光面が上記光導波構造に密着しないように上記漏 洩ビームのビームパラメータを変換する手段とを備えた 光変調器モジュール。

【請求項2】 請求項1に記載の光変調器モジュールで あって、

上記光導波構造は誘電体チップにより提供され、

上記駆動手段は上記誘電体チップ上で上記第1及び第2 パスにそれぞれ並設される第1及び第2の電極を含む光 変調器モジュール。

【請求項3】 請求項2に記載の光変調器モジュールで あって、

上記第1及び第2の電極に動作的に接続され上記結合モ ードと上記漏洩モードの有効な切換がなされるように上 30 記フォトディテクタの出力信号に基づき動作点を制御す る手段を更に備えた光変調器モジュール。

【請求項4】 請求項2に記載の光変調器モジュールで あって、

上記誘電体チップはリチウムナイオベートからなる光変 調器モジュール。

【請求項5】 請求項2に記載の光変調器モジュールで あって、

上記誘電体チップは上記第2端と実質的に同一平面上の 端面を有し、上記漏洩ビームは上記端面から放射され、 上記第2端に対向する開口を有し上記誘電体チップがそ の内部に収容されるパッケージを更に備えた光変調器モ ジュール。

【請求項6】 請求項5に記載の光変調器モジュールで あって、

上記変換する手段は上記誘電体チップと上記開口の間に 設けられるコモンレンズを含み、

上記第2端からの上記変調された光は上記コモンレンズ により集束されて上記開口を通過し、

上記漏洩ビームは上記コモンレンズにより集束されて上 50 一ル。

記受光面に入射する光変調器モジュール。

【請求項7】 請求項6に記載の光変調器モジュールで あって、

上記フォトディテクタは上記受光面が上記開口の上部に 位置するように設けられる光変調器モジュール。

【請求項8】 請求項5に記載の光変調器モジュールで あって、

上記変換する手段は上記誘電体チップと上記開口の間に 設けられ第1及び第2のレンズエレメントを有するアレ

上記第2端からの上記変調された光は上記第1のレンズ エレメントにより集束されて上記開口を通過し、

上記漏洩ビームは上記第2のレンズエレメントにより集 東されて上記受光面に入射する光変調器モジュール。

【請求項9】 請求項8に記載の光変調器モジュールで あって.

上記フォトディテクタは上記受光面が上記開口の下部に 位置するように設けられる光変調器モジュール。

【請求項10】 請求項5に記載の光変調器モジュール 20 であって、

上記フォトディテクタが固着される第1面及び上記パッ ケージ又は上記誘電体チップに固着される第2面を有す るセラミック基板を更に備えた光変調器モジュール。

【請求項11】 請求項5に記載の光変調器モジュール であって、

上記変換する手段は上記開口を封止するための窓部材を 含み、

該窓部材は上記第2端からの上記変調された光を透過さ せる第1面と上記漏洩ビームを反射させる第2面とを有 している光変調器モジュール。

【請求項12】 請求項11に記載の光変調器モジュー ルであって、

上記フォトディテクタは上記受光面が上記誘電体チップ の端面と反対側を向くように設けられる光変調器モジュ

【請求項13】 請求項5に記載の光変調器モジュール であって、

上記変換する手段は上記開口に沿って上記パッケージに 固着されるリング部材を含み、

該リング部材は概略円錐形の一部をなす反射面を有して

上記第2端からの上記変調された光は上記リング部材の 内側及び上記開口を通過し、

上記漏洩ビームは上記反射面で反射して上記受光面に入 射する光変調器モジュール。

【請求項14】 請求項13に記載の光変調器モジュー ルであって、

上記フォトディテクタは上記受光面が上記誘電体チップ の端面と反対側を向くように設けられる光変調器モジュ

10

3

【請求項15】 請求項5に記載の光変調器モジュール であって、

上記開口を封止するための窓部材を更に備え、

上記変換する手段は、上記誘電体チップの端面に固着され上記漏洩ビームの偏光面を90°回転させる1/2波長板と、上記窓部材に積層された光学膜とを含み、

上記漏洩ビームは上記光学膜で反射して上記受光面に入射する光変調器モジュール。

【請求項16】 請求項15に記載の光変調器モジュールであって、

上記フォトディテクタは上記受光面が上記誘電体チップ の端面と反対側を向くように設けられる光変調器モジュ ール。

【請求項17】 請求項1に記載の光変調器モジュールであって、

上記変換する手段は、上記変調された光及び上記漏洩ビームのいずれか一方の偏光面を90°回転させる旋光手段と、上記漏洩ビームの光路を上記変調された光の光路から分離するための複屈折結晶とを含む光変調器モジュール

【請求項18】 請求項17に記載の光変調器モジュールであって、

上記光導波構造は上記第2端と実質的に同一平面上の端面を有する誘電体チップにより提供され、

上記漏洩ビームは上記端面から放射され、

上記旋光手段は上記端面に固着される1/2波長板から なり、

上記複屈折結晶は上記1/2波長板を通過した上記漏洩 ビームが常光線及び異常光線のいずれか一方になるよう に配置される光変調器モジュール。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、一般的に、光源からの光を変調するための光変調器モジュールに関し、更に詳しくは、光パワーのモニタリングを行なうための上記モジュールの構造に関する。

【0002】光ファイバ通信システムにおいては、変調速度が増大してきた。レーザダイオードの直接強度変調では、波長チャーピングが問題である。チャーピングは、信号光が色分散(波長分散)のある光ファイバを通 40過するときに波形の歪みを引き起こす。ファイバ損失の観点からは、シリカファイバに適用されるのに最も望ましい波長は 1.55μ mである。この波長では、ノーマルなファイバは大体18ps/km/nmの色分散を持っている。これは伝送距離を制限する。この問題をさけるために、外部変調器として使用される光変調器モジュールに対する期待が高まっている。

[0003]

【従来の技術】実用的な外部変調器として、LiNbO 。基板を用いたマッハツェンダ型の光変調器(LN変調 50

器)が開発された。光源からの一定強度のキャリア光が LN変調器に供給され、光の干渉を用いたスイッチング 動作によって、強度変調された光信号が得られる。

【0004】しばしば指摘されるLN変調器の欠点は、動作点ドリフトを生じさせることである。動作点ドリフトに対処するために、LN変調器から出力される光のパワーがモニタリングされ、その結果得られる電気信号に基づいて動作点安定化のための制御が行なわれる。

[0005]

【発明が解決しようとする課題】光変調器が出力する光のパワーをモニタリングするためには、その一部をビームスプリッタにより分岐し、その分岐ビームをフォトディテクタで受ければよい。しかし、この場合、光変調器から出力される光信号のパワーが小さくなり、また、部品点数が多くなって装置が大型化するという問題がある。

【0006】このような点に鑑み、干渉に際して生じる 漏洩ビームを用いて光パワーをモニタリングすることが 試みられている(特開平3-145623号公報)。し 20 かし、漏洩ビームを用いた従来のモニタリング技術にお いては、漏洩ビームを受けるための受光面或いはファイ バ端面を光変調器チップの端面に直接実装しているの で、チップが破損しやすく、光変調器モジュールの製造 が容易でないという問題がある。

【0007】よって、本発明の目的は、漏洩ビームによる光パワーのモニタリングを可能にする製造性に優れた 光変調器モジュールを提供することにある。

[0008]

【課題を解決するための手段】本発明のある側面によると、入力ポートが受けた光を変調して変調された光を出力ポートから出力する光変調器モジュールが提供される。

【0009】光変調器モジュールは、例えば誘電体チップにより提供される光導波構造を有している。光導波構造は、入力ポート及び出力ポートにそれぞれ動作的に接続される第1端及び第2端と、第1端及び第2端にそれぞれ接続される第1Y部及び第2Y部と、第1Y部及び第2Y部の間に接続される第1パス及び第2パスとを有している。

【0010】結合モードと漏洩モードとを切り換えてそれにより変調された光が第2端から出力されるようにするために、駆動手段が第1パス及び第2パスの少なくともいずれか一方に電界を印加する。

【0011】結合モードでは、第2Y部を通過する光が第2端に供給され、これにより光変調器モジュールが出力する光がオンになる。漏洩モードでは第2Y部を通過する光が光導波構造からそれて漏洩ビームを生じさせ、これにより光変調器モジュールが出力する光がオフになる。このようにして、入力ポートが受けた光についての強度変調がなされる。

【0012】光変調器モジュールは、更に、漏洩ビーム を受ける受光面を有するフォトディテクタと、受光面が 光導波構造に密着しないように漏洩ビームのビームパラ メータを変換する手段とを有する。ビームパラメータ は、例えば、漏洩ビームの方向、偏光状態又は開口数で ある。

【0013】このように本発明の光変調器モジュール は、漏洩ビームのビームパラメータを変換する手段によ りフォトディテクタの受光面が光導波構造に密着しない ようにしているので、光変調器モジュールの製造性が改 10 善される。また、結合モードと漏洩モードは互いに相補 の関係にあるので、漏洩ビームを用いて光パワーのモニ タリングが可能になる。

【0014】光導波構造が誘電体チップにより提供され ている場合には、駆動手段は、誘電体チップ上で第1及 び第2パスにそれぞれ並設される第1及び第2の電極を 含むことができる。望ましくは、結合モードと漏洩モー ドの有効な切換がなされるように、フォトディテクタの 出力信号に基づき動作点を制御する回路が第1及び第2 の電極に動作的に接続される。

[0015]

【発明の実施の形態】以下、添付図面を参照して本発明 の望ましい実施の形態を詳細に説明する。図1を参照す ると、本発明が適用される光変調器モジュールの外観が 示されている。このモジュールは、入力ポート2が受け た光を変調して変調された光を出力ポート4から出力す る。この実施形態では、ポート2及び4はそれぞれ光コ ネクタである。

【0016】このモジュールは、後述する変調器チップ が内蔵されるパッケージ6を有している。パッケージ6 30 の両端には、ポート2及び4をそれぞれパッケージ6と 接続するためのピグテール型のファイバアセンブリ8及 び10が設けられている。

【0017】パッケージ6の一方の側面には、高速信号 用のコネクタ12及び14が設けられており、他方の側 面には低速信号用のコネクタ16が設けられている。パ ッケージ6を図示しないケース等に固定するために、パ ッケージ6の底部には金具18が固定されている。

【0018】図2を参照すると、パッケージ6(図1参 照)内に内蔵される変調器チップが示されている。この 40 変調器チップは、誘電体チップ20により提供される光 導波構造22を有している。誘電体チップ20は例えば LiNbO。(リチウムナイオベート)からなり、この 場合Ti (チタン) の熱拡散によって光導波構造22が 得られる。

【0019】光導波構造22は、図1の入力ポート2及 び出力ポート4にそれぞれ動作的に接続される第1端2 4及び第2端26を有している。本出願において、ある 要素と他の要素とが動作的に接続されるというのは、こ れらの要素が直接接続される場合を含み、更に、これら 50 る。チップ20の端面20Aから放射される漏洩ビーム

の要素の間で電気信号又は光信号の受渡しができる程度 の関連性を持ってこれらの要素が設けられている場合を 含む。

【0020】光導波構造22は、更に、第1端24及び 第2端26にそれぞれ接続される第1Y部28及び第2 Y部30と、Y部28及び30の間に接続される第1パ ス32及び第2パス34とを有している。

【0021】第1端24に供給された光は、第1Y部2 8で光パワーが実質的に2等分される第1及び第2のビ ームに分岐される。第1及び第2のビームはそれぞれパ ス32及び34により導波され、第2Y部30で干渉す

【0022】第2Y部30における第1及び第2のビー ム間の位相差に応じて、第2端26において出力ビーム が得られる結合モードと、第2Y部30から誘電体チッ プ20内に漏洩ビームが放射される漏洩モードとが切り 換えられる。

【0023】第1及び第2のビーム間の位相差を変化さ せるために、第1パス32上には接地電極38が設けら 20 れており、第2パス34上には信号電極36が設けられ ている。

【0024】信号電極36は、進行波型に構成されてお り、その入力端36Aはコネクタ12の内部導体に接続 され、出力端36日はコネクタ14の内部導体に接続さ れている。また、コネクタ12及び14のシールド並び に接地電極38は例えばパッケージ6 (図1参照)を介 して接地されている。

【0025】電極36及び38は例えばAu(金)の蒸 着により形成される。図示はしないが、誘電体チップ2 0と電極36及び38との間にSi及び/又はSiO₂ からなる安定化用の単一又は複数のバッファ層が設けら れていてもよい。

【0026】図3を参照すると漏洩ビームを更に詳細に 説明するために、変調器チップの破断斜視図が示されて いる。チップ20は、第2端26と実質的に同一平面上 の端面20Aを有している。

【0027】第2Y部30からチップ20内に放射され た漏洩ビームは、LBで示されるように、更に端面20 Aから空気中に放射される。また、Y部30における干 渉の結果生じた出力ビーム〇Bは、第2端26から空気 中に放射される。

【0028】図4を参照すると、漏洩ビームLBをモニ タリングするための第1実施形態が示されている。誘電 体チップ20は、パッケージ6の内面に固着されてい る。パッケージ6は、出力ビームOBを放射する第2端 26に対向する開口 6Aを有している。

【0029】開口6Aには、パッケージ6の内部を気密 に封止するためのサファイア等からなる窓部材40が設 けられている。パッケージ6の蓋の図示は省略されてい LBのビームパラメータを変換するために、チップ20 と開口6Aの間にコモンレンズ42が設けられている。 ここではコモンレンズ42は球レンズでありパッケージ 6の内面に接着剤44により固定されている。

【0030】第2端26から放射された出力ビームOB は、コモンレンズ42により集束されて窓部材40を透 過し、出力ポート4 (図1参照) に導かれる。パッケー ジ6の内面の開口6Aの上方には、セラミック基板46 を介してフォトディテクタ (例えばフォトダイオード) 48が設けられている。

【0031】セラミック基板46の底面46Aはパッケ ージ6の内面に固着され、セラミック基板46の頂面4 6 B上にはフォトディテクタ48の底部が固着されてい る。フォトディテクタ48はその頂部に受光面48Aを 有している。

【0032】チップ20の端面20Aから放射された漏 洩ビームLBは、コモンレンズ42により集束されてフ オトディテクタ48の受光面48Aに入射する。このよ うに一つのコモンレンズ42を用いて、出力ビームOB の邪魔をせずに漏洩ビームLBのモニタリングが可能な 20 のは、出力ビームOB及び漏洩ビームLBがチップ20 の異なる点から放射されているからである。

【0033】尚、コモンレンズ42の大きさは、出力ビ ームOBの光軸がコモンレンズ42の中心に実質的に一 致するように設定されている。これにより、漏洩ビーム LBはコモンレンズ42にその中心よりも下の位置から 斜めに入射するので、開口 6 Aの上部に位置するフォト ディテクタ48により漏洩ビームLBの一部又は全部を 受けることができる。

【0034】この実施形態では、漏洩ビームLBのうち 30 の一部でもフォトディテクタ48の受光面48Aに重な っていれば光パワーのモニタリングが可能になるので、 フォトディテクタ48の位置合わせ等が容易であり、モ ジュールを簡単に製造することができる。また、チップ 20の端面20Aには何も固着する必要がないのでチッ プ20の破損が防止され、製造歩留りが向上する。

【0035】フォトディテクタ48は電気的には図1の 低速用のコネクタ16に接続されている。この接続は例 えば次のようにしてなされる。セラミック基板46の頂 面46B上に導体パターンを形成し、この導体パターン 40 とフォトディテクタ48の出力端子とをボンディングワ イヤで接続し、導体パターンとコネクタ16とを適当な リード線により接続するのである。

【0036】このような接続形態によると、フォトディ テクタ48のセラミック基板46に対する機械的な固定 と電気的な接続とを予め行なってフォトディテクタアセ ンブリを構成しておき、このアセンブリをパッケージ6 の内面に固着することができるので、モジュールの組立 が容易になる。

て説明する。一般に誘電体チップを用いてなるマッハツ エンダ型の光変調器においては、温度変化や経時変化に より動作特性曲線がドリフトする(動作点ドリフト)。

【0038】図5において、符号50及び52はそれぞ れ動作点ドリフトが生じていない場合における動作特性 曲線及び出力光信号波形を表しており、符号54及び5 6 はそれぞれ動作点ドリフトが生じた場合における動作 特性曲線及び出力光信号波形を表している。符号58は 入力信号(駆動電圧)の波形である。

【0039】動作特性曲線は、光パワー(例えば図3の 10 出力ビーム〇Bのトータルパワー) が電圧の増加に対し て周期的に増減するものとして表される。従って、入力 信号の各論理値に対応して光パワーの極小値及び極大値 がそれぞれ得られる電圧V。及びV、を用いて前述の結 合モードと漏洩モードの有効な切り換えを行なうことに よって、効率的な2値変調を行なうことができる。

【0040】動作点ドリフトが生じたときに、電圧V。 及びV。が一定であると、動作特性曲線の周期性により 符号56で示されるように出力光信号の消光比が劣化す る。従って、動作点ドリフトが生じたときにそのドリフ ト量をdVとすると、電圧V。及びV,をそれぞれ(V 。 + dV) 及び $(V_1 + dV)$ として動作点ドリフトを 補償することが要求される。

【0041】本発明では、動作点ドリフトの安定化制御 に漏洩ビームのモニタリングを適用することができる。 図6を参照すると図2の変調器チップの動作特性が示さ れている。与えられた任意の電圧に対して出力ビームO Bの光パワーと漏洩ビームLBの光パワーの和は一定で ある。即ち、出力ビームOBと漏洩ビームLBは互いに 相補の関係にある。

【0042】従って、図2の変調器チップが動作してい る状態においては、出力ビームOBの平均光パワーは漏 **洩ビームLBの平均光パワーに反映されるのである。図** 7を参照すると、本発明の光変調器モジュール60を有 する光送信機が示されている。レーザダイオードモジュ ール等の光源60からの一定強度のキャリア光が入力ポ ート2に供給される。

【0043】変調回路62は、入力信号の論理レベルに 対応して出力ポート4から出力する光がオン/オフする ような位相変化が光パス32及び34 (図2参照) の導 波光に与えられるように、高速の駆動電圧信号(変調信 号)をキャパシタ64を介してコネクタ12に供給す る。

【0044】動作点制御回路66は、漏洩ビームのパワ ーに対応するコネクタ16の出力信号を受け、この出力 信号に基づき動作点ドリフトを検出して、図5により説 明した原理に従って動作点が動作特性曲線に対して一定 の関係を有するような位相変化がパス32及び34の導 波光に与えられるように、制御された直流のバイアス電 【0037】次に図5を参照して動作点ドリフトについ 50 圧を発生する。バイアス電圧はインダクタ68を介して

コネクタ14に与えられる。コネクタ14を高周波的に 終端するために、キャパシタ70及び終端抵抗72が直 列でコネクタ14に接続される。

【0045】この光送信機においては、光変調器60の 動作点が常に最適に安定化されるので、動作点ドリフト に起因する出力波形の劣化或いは出力波形の反転を防止 して伝送品質を向上させることができる。

【0046】尚、動作点制御回路66は、例えば、発振 器からの低周波信号を高速の変調信号に重畳する手段 と、低周波信号を参照信号としてコネクタ16の出力信 10 号を同期検波する手段と、同期検波の結果得られたDC 信号が一定になるようにバイアス電圧を制御する手段と から構成することができる。

【0047】図8を参照すると、本発明による漏洩ビー ムのモニタリングの第2実施形態が示されている。この 実施形態は、図4の第1実施形態と対比して、コモンレ ンズ42に代えてアレイレンズ74が用いられている点 で特徴づけられる。

【0048】アレイレンズ74はパッケージの開口6A と誘電体チップ20との間に設けられており、その上部 20 及び下部にそれぞれレンズエレメント76及び78を一 体に有している。

【0049】出力ビームOBはレンズエレメント76に より集束されて窓部材40を透過し、漏洩ビームLBは レンズエレメント78により集束されてフォトディテク タ48の受光面48Aに入射する。

【0050】フォトディテクタ48は、パッケージ6の 内面の開口6Aの下方にセラミック基板46を介して固 定されている。このようなアレイレンズ74の採用によ り、図4の第1実施形態と対比して、出力ビーム〇Bの 30 光軸と漏洩ビームLBの光軸とが開口6Aと誘電体チッ プ20との間で交差しなくなり光軸同士ほぼ平行になる ので、開口6Aの下方に位置するフォトディテクタ48 により漏洩ビームLBの一部又は全部を受けることがで きる。

【0051】尚、アレイレンズ74は例えばプレスによ り作製される複数の非球面レンズを有している。図9を 参照すると、本発明による漏洩ビームのモニタリングの 第3実施形態が示されている。ここでは、パッケージの 開口6Aは第1及び第2実施形態と異なる形状の窓部材 40 80により密閉されている。即ち、窓部材80は漏洩ビ ームLBの一部又は全部を反射させるための傾斜した反 射面80Aを有している。

【0052】図示された例では、反射面80Aは窓部材 80の外側に形成されているが、内側に形成されていて もよい。フォトディテクタ48は受光面48Aが誘電体 チップ20の端面20Aと反対側を向くように端面20 A上にセラミック基板46を介して固定されている。

【0053】この実施形態では、漏洩ビームLBを集束 させるためのレンズが用いられていない。しかし、一般 50 にフォトディテクタ48の受光面48Aは例えば数百μ mの直径を有しているので、Y部30(図2及び図3参 照)と誘電体チップ20の端面20Aとの相対的な位置 関係を調整して漏洩ビームLBの開口(放射の立体角) を小さくすることによって、漏洩ビームLBの大部分を フォトディテクタ48で受けることができる。

10

【0054】また、フォトディテクタ48は受光面48 Aが誘電体チップ20の端面20Aと反対側を向くよう に設けられているので、フォトディテクタ48及びセラ ミック基板46を誘電体チップ20に固着するに際して 端面20Aの傷等を考慮する必要がないので、製造歩留 りが向上する。

【0055】この実施形態では、出力ビーム〇Bを集束 させるためのレンズがハウジング6の内部に設けられて いないので、そのレンズは図1のファイバアセンブリ1 0内に設けることができる。

【0056】図10を参照すると、本発明による漏洩ビ ームのモニタリングの第4実施形態が示されている。窓 部材40は第1及び第2実施形態におけるものと同じで ある。

【0057】漏洩ビームLBの一部又は全部を反射させ るために、開口 6 Aに沿ってパッケージ 6 の内面にリン グ部材82が固着されている。リング部材82は概略円 錐形の一部をなす反射面82Aを誘電体チップ20の側 に有している。

【0058】出力ビームOBはリング部材82の内側を 通って窓部材40を透過し、漏洩ビームLBの一部又は 全部は反射面82Aで反射してフォトディテクタ48の 受光面48Aに入射する。フォトディテクタ48の配置 形態は第3実施形態と同じである。

【0059】この実施形態によっても誘電体チップ20 の端面20Aと反対側を向く受光面48Aにより漏洩ビ ームLBの一部又は全部を受けることができるので、製 造歩留りが向上する。また、リング部材82は金属に対 する通常の加工方法により高精度に作製することがで き、リング部材82のパッケージ6への固着も容易に行 なうことができるので、このモジュールの製造は極めて 容易である。

【0060】反射面82Aはリング部材82の表面の研 磨によって得ることもできるが、全反射膜の蒸着によっ て得てもよい。図11を参照すると、本発明による漏洩 ビームのモニタリングの第5実施形態が示されている。 ここでは、パッケージの開口6Aには、上部がパッケー ジ6の内部に傾斜した窓部材84が設けられている。

【0061】窓部材84には特定の偏光面を有するビー ムを反射させるための光学膜86が積層されている。光 学膜86は図示された例では窓部材84の内側に積層さ れているが、外側に積層されていてもよい。

【0062】一般に、誘電体チップ20の上面に電極3 6及び38 (図2参照) を形成して、光導波構造22に

図11の上下方向に電界を印加する場合、出力ビームO B及び漏洩ビームLBの各々は、図11の紙面に平行な 偏光面を有するTM偏光となっている。

【0063】この実施形態では、漏洩ビームLBだけを 紙面に垂直な偏光面を有するTE偏光に変換するため に、誘電体チップ20の端面20A上に1/2波長板8 8を固着している。

【0064】そして、光学膜86はTM偏光を透過させ、TE偏光を反射させる特性を有している。従って、出力ビームOBは光学膜86及び窓部材84を透過し、漏洩ビームLBは光学膜86で反射する。反射した漏洩ビームLBの一部又は全部はフォトディテクタ48の受光面48Aに入射する。

【0065】フォトディテクタ48は、受光面48Aが誘電体チップ20の端面20Aと反対側を向くようにセラミック基板46を介して端面20Aに固定されている。この実施形態においても、フォトディテクタ48の受光面48Aが誘電体チップ20の端面20Aと反対側を向くようにされているので、製造歩留りが向上する。

【0066】図12を参照すると、本発明による漏洩ビ 20 ームのモニタリングの第6実施形態が示されている。ここでは、漏洩ビームLBのビームパラメータを変換する手段は、出力ビームOB及び漏洩ビームLBのいずれか一方の偏光面を90°回転させる旋光手段と、漏洩ビームLBの光路を出力ビームOBの光路から分離するための複屈折結晶92とを含む。

【0067】具体的には、旋光手段は誘電体チップ20の端面20Aに固着される1/2波長板90からなり、 複屈折結晶92は、1/2波長板90を通過した漏洩ビームLBが常光線及び異常光線のいずれか一方になるよ 30うに配置される。

【0068】この実施形態では、複屈折結晶92の材質はルチルであり、漏洩ビームLBは1/2波長板90によりTE偏光に変換され、複屈折結晶92において異常光線として出力ビームOBから下方向に分離される。この実施形態によると、出力ビームOBと漏洩ビームLBをの間の距離を拡大することができるので、容易に漏洩ビームLBのモニタリングを行なうことができる。

【0069】各ビームの偏光方向等の適切な設定によって出力ビームOBと漏洩ビームLBとが水平方向に分離 40 されるようにしてもよい。

[0070]

【発明の効果】以上説明したように、本発明によると、漏洩ビームによる光パワーのモニタリングを可能にする 製造性に優れた光変調器モジュールの提供が可能になる という効果が生じる。

【0071】また、本発明の特定の実施形態によると、 漏洩ビームのモニタリングにより光変調器の動作点の安 定化が可能になるという効果もある。 【図面の簡単な説明】

【図1】本発明が適用される光変調器モジュールの外観 を示す平面図である。

12

【図2】図1のモジュールに内蔵される変調器チップの 平面図である。

【図3】漏洩ビームを説明するための変調器チップの破断斜視図である。

【図4】本発明による漏洩ビームのモニタリングの第1 実施形態を示す光変調器モジュールの部分断面図であ 10 る。

【図5】動作点ドリフトの説明図である。

【図6】変調器チップの動作特性を示す図である。

【図7】本発明の光変調器モジュールが適用される光送 信機のブロック図である。

【図8】本発明による漏洩ビームのモニタリングの第2 実施形態を示す光変調器モジュールの部分断面図である

【図9】本発明による漏洩ビームのモニタリングの第3 実施形態を示す光変調器モジュールの部分断面図であ ス

【図10】本発明による漏洩ビームのモニタリングの第4実施形態を示す光変調器モジュールの部分断面図である。

【図11】本発明による漏洩ビームのモニタリングの第 5実施形態を示す光変調器モジュールの部分断面図であ る。

【図12】本発明による漏洩ビームのモニタリングの第6実施形態を示す光変調器モジュールの主要部の部分斜視図である。

30 【符号の説明】

2 入力ポート

4 出力ポート

6 パッケージ

12, 14, 16 コネクタ

20 誘電体チップ

22 光導波構造

28 第1 Y部

30 第2Y部

32 第1パス

34 第2パス

36 信号電極

38 接地電極

42 コモンレンズ

74 アレイレンズ

82 リング部材

88,90 1/2波長板

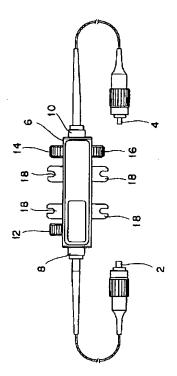
92 複屈折結晶

OB 出力ビーム

LB 漏洩ビーム

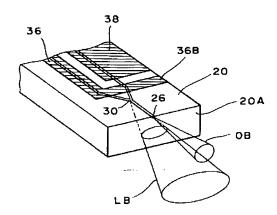
【図1】

光変調器モジュールの外観を示す平面図



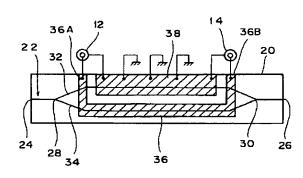
【図3】

漏洩ビームの説明図



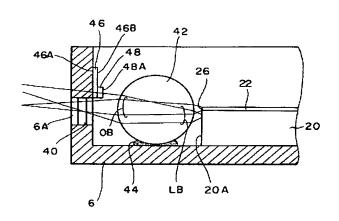
【図2】

変調器チップの平面図



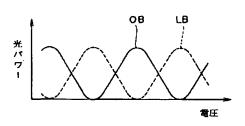
【図4】

第1実施形態を示す部分断面図



【図6】

動作特性を示す図

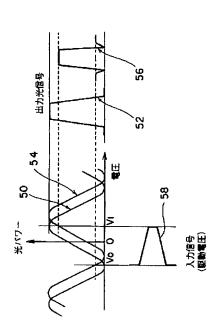


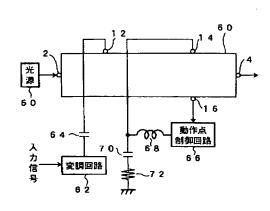
【図5】

動作点ドリフトの説明図

【図7】

光送信機のブロック図

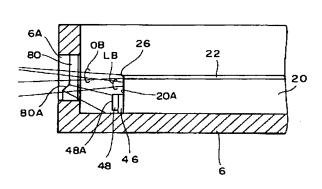


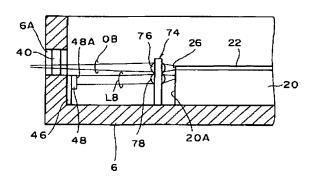


【図9】

第3実施形態を示す部分断面図

【図 8 】 第 2 実施形態を示す部分断面図



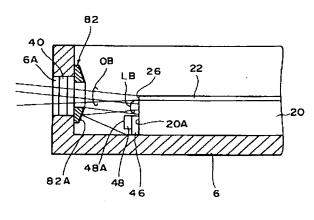


【図10】

第4実施形態を示す部分断面図

【図11】

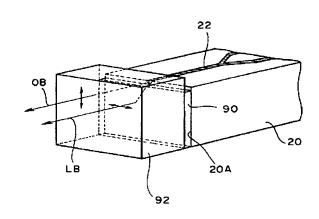
第5 実施形態を示す部分断面図



【図12】

86 84 08 26 6A LB 88 22 20A 20A 20 48A 46

第6実施形態を示す主要部の部分斜視図



フロントページの続き

(72) 発明者 大谷 俊博

北海道札幌市中央区北一条西2丁目1番地 富士通北海道ディジタル・テクノロジ株 式会社内 (72) 発明者 久保田 嘉伸

神奈川県川崎市中原区上小田中4丁目1番 1号 富士通株式会社内

(72)発明者 大森 康弘

神奈川県川崎市中原区上小田中4丁目1番 1号 富士通株式会社内